

1		2										3										4																			
		수 정 내 용																																							
												부호										내 용					수정자					승인자					년 월 일				
ST(기초)																																									
ST(개선)																																									

6	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00022-15/1 (LB002)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00882-N/1 (HB007)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00937-135/1 (EB006)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01330-135/1 (DB050B)
1	BODY	1	BeCu	Gold Plate	DBD01168-1345/1 (DB050)

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차		년월일 2001. 5. 4. 승인 감도 재도 작성부서 연 구 소 적도 4/1 단위 mm 총량 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017					
.* ±0.1		도명 D-SUB-LPC-141					
.** ±0.05							
재질							
열처리							
보호피막처리							

1
2
3
4